证券代码：300054　　证券简称：鼎龙股份　　公告编号：2026-013

湖北鼎龙控股股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ✓不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ✓不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

✓适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ✓不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨平彩	黄云	
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，并致力于成为全球领先的创新材料平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。此外，公司在传统打印复印通用耗材业务领域进行了全产业链布局。

★ 业务概要

（1）半导体业务

A.半导体制造用工艺材料-CMP制程工艺材料

CMP抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据SEMI数据，CMP抛光材料在集成电路制造材料成本中占比7%，其中CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液合计占CMP抛光材料成本的85%以上。根据TECHCET预测显示，2029年全球半导体CMP抛光材料市场规模将超过50亿美元，2024-2029年复合增长率为8.6%。公司致力于为国晶圆制造企业提供一站式CMP核心材料与整体解决方案，持续强化CMP环节的系统化产品供给能力，专业技术服务能力与综合方案解决能力，已成为国内首家、唯一一家覆盖集成电路CMP全品类材料的综合解决方案供应商。

在CMP抛光垫产品方面，公司目前是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商，确立CMP抛光垫国产供应龙头地位，产品深度渗透国内主流晶圆厂客户，成为部分客户的第一供应商，被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商。

在CMP抛光液产品方面，公司开展全制程及多品类CMP抛光液产品布局，搭配自主研磨粒子在客户端持续推广、导入，部分品类进入快速放量阶段。

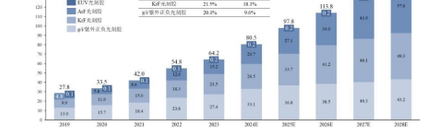
在清洗液产品方面，公司铜制程CMP后清洗液持续稳定获得订单，其他制程抛光后清洗液产品结合整体业务战略安排进行开发验证，持续完善业务布局。

图2.2.1：鼎龙CMP制程工艺材料产品简介

B.半导体制造用—高端晶圆光刻胶

晶圆光刻胶是半导体光刻工艺中的关键材料，目前国内在先进的KrF、ArF、EUV光刻胶领域尚未实现大规模量产，而KrF、ArF光刻胶因其覆盖了从0.25?m到7nm的主要半导体先进制造工艺，是部份段迫切需要实现技术突破的半导体关键材料，具有十分重要的战略意义和经济价值。根据弗若斯特沙利文市场研究，预计2028年中国半导体光刻胶市场市场规模将达到150.3亿元，2023~2028年的年复合增长率18.5%，高于全球半导体光刻胶市场规模增速，其中：KrF光刻胶市场规模将达到49.3亿元、ArF光刻胶市场规模将达到57.6亿元。

图：境内2019-2028年半导体光刻胶市场规模分析



来源：Frost & Sullivan

图2.2.2：境内2019~2028年半导体光刻胶市场规模分析，来源Frost & Sullivan

公司着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，实现高端光刻材料产业化，推动高端光刻胶国内自主化供应进程。公司自2022年5月布局高端晶圆光刻胶业务，截至报告期，已实现从产品研发、小中试线建设、订单获取，到建成国内首条"有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配"全流程的高端晶圆光刻胶量产线，并完成产品稳定批量供应，成为国内该领域推进速度最快、技术水平对标国际一流、ArF和KrF光刻胶产品在国内实现"全制程"与"全尺寸"覆盖的高端晶圆光刻胶企业。

图2.2.3：鼎龙高端晶圆光刻胶产品简介

C.半导体显示材料

公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心材料布局，推出黄色聚酰亚胺浆料YPI、光敏聚酰亚胺浆料PSPI、薄膜封装材料TFE-INK等系列产品。据群智咨询（Sigmaintell）2026年2月发布数据，2025年全球柔性OLED智能手机面板出货量达6.9亿片，同比增长9.6%，中国厂商在柔性OLED市场份额已达57.9%。目前，公司YPI、PSPI、TFE-INK产品已在客户端规模销售，并已成为国内部分主流面板客户YPI、PSPI产品国产供应领先地位。同时，公司凭借在OLED显示材料领域多年的积累，对标国际一流共同探索未来显示技术工艺路线及相应材料应用方向，努力成为新型显示前沿技术的创新材料支持商。

图2.2.4：鼎龙半导体显示材料产品简介

D.半导体先进封装材料

先进封装作为摩尔定律逼近物理极限背景下的核心突破路径，凭借异构集成、性能倍增的技术优势，已成为半导体产业持续升级的关键赛道。在全球产业竞争格局深度调整的背景下，先进封装更成为支撑国内半导体产业突破发展瓶颈、实现技术迭代的重要抓手。

公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局，目前重点开发半导体封装PI、临时键合胶等产品，快速推动先进封装材料项目的产品开发验证、市场推广，进一步巩固产业竞争力，助力半导体封装产业实现高质量发展。

图2.2.5：鼎龙半导体先进封装材料产品简介

E.集成电路芯片设计和应用

集成电路芯片设计是集成电路产业链上游的重要环节。公司子公司旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域18年，拥有自主独立知识产权产品，国内领先的公司自有芯片分析实验室，是国家高新技术企业，纳入国家发改委重点布局软件企业，是国家级专精特新小巨人企业。公司稳步完善芯片产品矩阵，同时针对芯片制造环节部分关键技术的问题，积极在半导体零部件控制系统产品领域进行布局和探索。

图2.2.6：鼎龙集成电路芯片产品简介

（2）打印复印通用耗材业务

打印复印通用耗材行业市场竞争模式较为成熟，通用耗材市场份额更多倾向综合实力强、具有技术卡位和规模优势、品牌影响力较大、产品价低质优的头部企业。公司以全产业链运营为发展思路，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司的竞争优势地位。目前，公司是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。彩色碳粉领域，公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺，且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业；再生墨盒领域，子公司绩迅科技是国家工信部再制造墨盒产品认定的首家企业，是国家级专精特新小巨人企业。

图2.2.7：鼎龙打印复印通用耗材产品简介

★ 经营情况与主要业绩驱动因素

鼎龙股份致力于成为全球领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司。在材料创新平台的搭建过程中，鼎龙一直坚持"四个同步"：一是坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步；二是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步；三是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；四是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步，以此引领企业持续创新发展。

2025年度，公司实现营业收入36.6亿元，同比增长9.66%；实现归属于上市公司股东的净利润7.2亿元，同比增长38.32%。其中，今年第四季度：实现营业收入9.62亿元；实现归属于上市公司股东的净利润2.01亿元，同比增长39.07%。经营业绩同比变动的原因主要系：

①半导体业务实现营收与利润双增长，经营质效稳步提升。报告期内，公司半导体业务延续收入、利润持续增长的良好态势。其中，CMP抛光材料、半导体显示材料在国内主流晶圆制造企业及显示面板厂商的客户渗透力度持续加大，半导体先进封装材料新品逐步实现规模化销售，共同驱动半导体业务收入稳步增长。同时，依托产能释放带来的规模效应、供应链体系持续优化及生产工艺不断改良，半导体业务保持较强盈利能力，其归属于母公司所有者的净利润规模同比实现大幅增长。

②公司全面推进降本控费与精益运营，整体运营效率显著改善。报告期内，公司紧密结合业务实际，围绕生产工艺、能源动力、集中采购、设备维保等关键环节实施全流程精细化管控，在保障经营效益、提升运营质量的前提下有效降低运营成本，进一步增强公司整体盈利能力。

③报告期内，因实施上市公司股权激励计划，计提股份支付费用4,552万元，从而影响公司归母净利润4,203万元。

④报告期内，高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务尚属于市场开拓及放量初期，尚未盈利，且持续投入，一定程度上影响了本报告期的归母净利润水平。

本报告期，公司经营性现金流量净额为11.56亿元，同比增长39.64%，现金流情况稳健，为公司各项业务的发展、投入提供了有力支持。公司维持较高研发投入力度，报告期内研发投入金额5.19亿元，较上年同期增长12.32%，占营业收入的比例为14.19%，为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实的支撑，创新材料与技术的平台化布局持续完善，综合创新能力得到进一步巩固与提升。

本报告期，公司在行业内及资本市场获评多项荣誉：

①行业内所获荣誉：旗下控股子公司一圣显科技成为旗下第2家入选国家专精特新重点"小巨人"企业的公司，鼎泽新材料成为旗下第5家入选国家专精特新"小巨人"企业的公司；鼎汇微电子、圣显科技分别获得多家国内主流晶圆厂客户、主流面板厂客户的合作奖项；"OLED显示屏用无氟光敏聚酰亚胺材料"荣获中国电子材料行业协会—创新突破奖等。上述荣誉展现了公司平台型创新材料平台型企业的综合实力、行业影响力及产品竞争力。

②资本市场端所获荣誉：公司荣获深交所信息披露A级评级，连续3年获得A级评价；入选"创业板上市公司价值50强"、上海证券报"金质量-科技创新奖"、中上协"ESG可持续发展优秀实践案例"等称号；公司董事会秘书荣获"金牛董秘奖"、2025新财富最佳董秘奖"。上述荣誉彰显了监管机构和资本市场对公司在信息披露质量、规范运作水平、投资者关系管理等方面的高度认可与肯定。

③可持续绿色发展：公司发布首份《可持续发展报告》，首次获得国内权威金融数据平台万得Wind的ESG"A"评级。公司持续践行"绿色智造"理念，公司控股子公司鼎汇微电子入选国家绿色制造名单，本公司入选湖北省绿色制造名单，彰显了公司在绿色制造体系建设中的示范引领作用。以科技创新驱动绿色转型，为可持续高质量发展注入新动能。

为持续落实公司"创新材料平台型企业"战略发展目标，培育多领域产业增长极，公司于2026年第一季度收购国内绝对头部动力电池及储能电池企业供应链内的核心功能工艺性辅材类供应商—深圳市皓飞新型材料有限公司70%股权，加强了公司在新能源材料赛道的业务布局和竞争力，通过发挥公司平台化优势、整合双方技术与研发资源、拓展业务边界，构建公司全新业绩增长引擎。

本报告期，公司主要业务进展情况如下：

（1）半导体业务

2025年，公司半导体板块业务（含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务）实现主营业务收入20.86亿元（其中芯片业务收入已剔除内部抵消），同比增长37.27%，占公司总营业收入57%，标志着公司半导体业务成为公司核心盈利支柱与战略发展主引擎，进一步实现从产品布局到规模领跑的跨越，业务结构转型升级取得显著经营成效。各细分业务具体进展如下：

A.CMP抛光垫业务：2025年，累计实现产品销售收入10.91亿元，同比增长52.34%；其中，第四季度实现产品销售收入2.96亿元，同比增长53.4%。公司于2025年首次实现抛光垫单月销量破4万片的历史新高，CMP抛光垫国产供应龙头地位进一步夯实。

抛光硬垫方面，公司持续推进产品迭代升级，全面适配下游客户多元化、高端化需求，产品技术节点持续提升。客户拓展成效显著，海外市场布局有序推进，已与多家海外客户达成合作意向并稳步推进产品导入；本土外资晶圆厂客户市场推广也在持续进行中。产能建设方面，武汉本部抛光硬垫产线产能至2026年一季度末已达到月产5万片左右（即年产约60万片），产能利用率持续提升。

抛光软垫方面，公司产品矩阵进一步丰富，软垫及缓冲垫持续稳定放量供应，业内知名度持续提升，潜江工厂盈利水平稳步优化；公司积极拓展大硅片、第三代半导体、先进封装等新领域市场，成功切入并获取订单，产品应用场景持续拓宽。公司正在建设的光电半导体材料研发制造中心项目，包含40万片大硅片抛光垫等产能，项目投产后，将进一步增强公司在相关领域的综合竞争力。

原材料方面，公司持续强化核心原材料自主制备能力，保障供应链稳定高效。其中，预聚体持续实现稳定供应；微球产品实现关键突破，仙桃园区微球产线已正式量产，生产良率处于较高水平。公司正在建设的光电半导体材料研发制造中心项目，配套了年产4,000吨预聚体、200吨微球发泡等相关产能，可进一步满足公司未来抛光垫产品生产需求。

生产运营方面，公司持续推进产线智能化升级，对部分产线进行AI功能改造，通过智能化技术赋能生产全流程，有效提升生产效率、优化生产管控水平，进一步优化生产成本，助力公司实现精益运营，为产品产能释放、良率提升提供了有力支撑。

B.CMP抛光液、清洗液业务：2025年，累计实现产品销售收入2.94亿元，同比增长36.84%；其中，第四季度实现产品销售收入9,132万元，同比增长21.72%。

CMP抛光液产品中铜及铜阻挡层、金属栅极（钨、铝）、浅槽隔离等新品类不断突破，多晶硅、氮化硅等品类持续稳步放量。核心原材料研磨粒子自主供应链优势持续巩固，搭载自产四大体系研磨粒子（超纯氧化硅溶胶、高纯氧化硅溶胶、氧化铝、氧化铈）的抛光液产品市场接受度稳步提升，为产品市场拓展与产能释放提供坚实支撑。

铜及铜阻挡层抛光液，搭载自主化氧化硅研磨粒子等核心原材料，产业化推进成效显著。报告期内，相关产品实现首次订单落地，多款产品在客户端持续稳定上量，另有多款产品在客户端加速导入中。

金属栅极（钨、铝）抛光液，依托自主化氧化铝研磨粒子等核心原材料，客户认可度与需求度持续提升。存量客户端供应量稳定扩增，并不断有新型号产品通过验证并持续上量。

浅槽隔离抛光液，采用自主化氧化铈研磨粒子等核心原材料，在客户端验证实现重大突破，多款产品验证顺利并进入收尾阶段，为后续订单拓展奠定坚实基础。

多晶硅、氮化硅等抛光液，存量客户用量持续提升，同时积极配合客户工艺需求开发定制化产品，围绕研磨粒子性能优化与化学配方升级双向发力，相关产品品类已稳居国内领先地位。

清洗液方面，铜CMP后清洗液产品在国内多家客户实现增量销售，销售收入稳步提升；其他制程清洗液持续拓展市场，取得稳定销售收入。同时，另有多款清洗液新产品在客户端持续开展技术验证，产品矩阵不断丰富，为后续市场拓展奠定基础。

公司自产研磨粒子的供应链优势持续凸显，一方面，公司实现了核心原材料及供应链的安全可控，另一方面，可满足下游客户在技术、工艺持续迭代背景下的定制化需求。随着自产研磨粒子持续放量，其为公司抛光液带来的成本优势也将逐步显现。此外，公司产品组合方案持续完善，多晶硅抛光液与配套清洗液的产品组合方案获得国内主流逻辑晶圆厂客户技术认可，取得"抛光液+清洗液"的组合订单。公司CMP抛光液、清洗液产品市场渗透的加深与新品订单的增长，将为后续销售收入的增长注入新动能。

C.半导体显示材料业务：2025年，累计实现产品销售收入5.44亿元，同比增长35.47%；其中，第四季度实现产品销售收入1.31亿元，同比增长9.14%。

公司YPI、PSPI产品在国产供应领域的领先地位持续稳固，作为国内多家主流面板厂的核心供应商，产品市场占有率稳步提升；其中YPI销量稳步增长、PSPI销量实现大幅增长，月出货量创新高；海外市场的拓展与验证工作正按计划有序推进，为后续订单规模的持续增长奠定了坚实基础。TFE-INK产品进入持续放量阶段，客户拓展成效显著，市场份额持续提升。

产能布局持续完善，仙桃产业园年产1,000吨PSPI产线已顺利投产并实现稳定批量供货，进一步提升了公司的产能规模与生产体系运营能力；YPI产品扩产工作有序落地，仙桃年产800吨YPI二期项目已如期完工并进入试运行阶段，有效缓解了武汉本部YPI一期产线的产能压力，为应对未来持续增长的订单需求提供了可靠保障。

新产品研发领域，公司与国际顶尖厂商同台竞技，聚焦新一代OLED显示材料创新，持续推进无氟光敏聚酰亚胺（PFAS Free PSPI）、黑色像素定义层材料（BPDL）、薄膜封装低介电材料（Low Dk INK）等产品的研发与送样验证工作，致力于填补国内相关领域技术空白。目前，公司PFAS Free PSPI、BPDL产品的各项性能指标均达到国内领先水平，在下游客户之力配合中不断加强性能优化并逐步落实验证工作。PI取向液产品开发进程加快，客户端验证工作已全面铺开。此外，中大尺寸OLED有望成为公司半导体显示材料业务的新增长极，公司数款产品已通过客户G8.6代线验证，产品导入顺利。

报告期内，公司持续深化生产管理与质量管控，全力保障产品质量稳定与交付及时；创新产品分析检测方法，持续推进降本增效，不断优化运营效能；持续深化供应链自主化布局，进一步提升核心原材料供应的安全性与稳定性，合理优化采购成本，进一步增强综合竞争力。

D.高端晶圆光刻胶业务：公司浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶业务稳步推进、加速突破，在国内实现"全制程"与"全尺寸"覆盖。产品开发及市场拓展方面，公司已布局超30款高端晶圆光刻胶，超20款产品完成客户送样验证，其中超12款进入加仑样测试阶段，验证进展顺利。同时，公司还布局了数款配套的BARC、SOC等光刻辅材。报告期内，ArF、KrF光刻胶产品分别实现新的订单突破，已有3款产品进入稳定批量供应阶段，同时成功开拓多家新客户并同步开展产品验证，客户结构持续优化，商业化进程显著加快。

产线建设方面，公司潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线稳定运行，具备批量化生产及供货能力，有效支撑产品送样与客户验证；二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线的主体厂房及配套设施均已建成，成为国内首条"有机合成-高分子合成-精制纯化-光刻胶混配"全流程的高端晶圆光刻胶量产线，产线对标国际一流，实现高度自动化、信息化，同步完成产线与控制系统数据库搭建及AI分析赋能，大幅提升研发转化效率，有力推动光刻胶产品从实验室成果向规模化稳定量产的高效转化。

供应链管理方面，公司持续开发ArF、KrF光刻胶专用树脂及高纯度单体、光敏产酸剂等关键材料，积极深化国内产业链合作，推进关键材料与光刻胶产品全流程国产化，供应链安全可控性领先。体系建设方面，公司构建全链条、全过程、全员参与的三位一体预防性质量管理体系，建成高标准光刻胶检测分析实验室与应用评价实验室，保障产品质量稳定可靠、批次一致性优异。

E.半导体先进封装材料业务：2025年销售收入1,176万元。2025年，公司半导体先进封装材料产品实现销售规模快速提升，整体业务迈入稳步放量新阶段，新产品验证导入与市场推广成效显著。半导体封装PI方面，公司已布局7款产品，目前共有2款产品取得多家客户订单，在售型号数量及覆盖客户范围持续扩大，订单增长动能进一步增强。临时键合胶方面，在已有客户实现稳定规模出货的同时，成功取得新客户订单突破，市场拓展与产品应用持续深化。报告期内，半导体先进封装板块整体销售额突破千万元大关，业务规模实现跨越式提升。此外，公司持续推进重点产品在国内各主流封测厂客户的验证导入，积极开拓新的重点客户群体，不断拓宽业绩增长空间与产品市场局边界，为半导体先进封装材料业务长期发展奠定坚实基础。

F.集成电路芯片设计和应用：报告期内，受市场竞争加剧影响，打印耗材芯片产品单价有所下行，对芯片业务销售收入及归母净利润带来一定阶段性影响。公司积极应对市场变化，推出多款具备较强市场竞争力的新品，进一步丰富与完善芯片产品矩阵；通过持续优化芯片设计方案，产品性能与成本竞争力得到显著提升，有效巩固了公司在核心业务领域的市场优势地位。同时，公司积极推进在半导体产业链关键环节的战略布局，在半导体零部件控制系统产品领域实现业务突破，与国内主流晶圆厂商的技术研发合作持续深化，核心技术攻关及产品验证进展顺利，为公司培育新的业务增长点、实现产业升级奠定基础。

(2)打印复印通用耗材业务

公司打印复印通用耗材业务整体经营保持稳定可控，2025年实现销售收入15.59亿元（不含打印耗材芯片），较上年同期下降12.97%。公司耗材业务坚持以利润目标为核心导向，持续主动调整缩减低毛利产品的客户结构和产品品类，持续推进降本控费、提质增效工作，通过优化运营效率、增强核心产品竞争力，实现传统耗材业务平稳运行。报告期内，公司持续强化重点运营费用精细化管控，多项重点费用管控成效显著；通过客户结构优化、仓储布局优化、节能降耗及费用细分管控等多重举措，深度挖掘内部运营潜力，运营质量持续改善。持续推进人员组织架构优化，落实人效提升举措，整体人均创收保持稳定，上游碳粉板块、下游耗材成品墨盒板块人均创收等指标同比稳步提升。产品创新与业务拓展取得重要突破，基于自有聚酯碳粉技术平台，通过配方创新与工艺优化，成功开发出适配理光机器的高端兼容碳粉，产品性能媲美原装水平且具备更优光泽度，目前已实现稳定生产与销售，为打印复印耗材板块开辟新的增长点，助力国产兼容耗材向高品质、高可靠性方向升级，碳粉业务盈利能力保持稳固。风险管控持续强化，应收账款、存货规模较年初进一步下降，有效降低业务运营风险，资产周转效率显著提升。公司将继续坚持精益运营与产品升级双轮驱动，不断夯实耗材业务可持续发展基础。

(3)管理效能提升

公司立足高端材料主业，深耕核心领域，以管理提质增效、赋能战略落地为核心目标，创新构建三大赋能体系，持续优化管理架构、激活内生发展动能，不断强化核心竞争优势，助力公司实现高质量发展，进一步巩固行业领先地位。

A.产业链赋能：精研全链条管理流程，提升运营协同效能。公司系统梳理生产、研发、营销、行政等核心业务链路，剔除冗余环节，明确权责边界，构建标准化、规范化流程管控体系，实现各部门、各环节高效联动、协同发力；推行流程数字化升级，精简审批节点，压缩办理周期，显著提升行政办公与业务处置效率；建立流程动态迭代机制，定期复盘运行成效，持续优化流程适配性，有效降低运营管理成本，实现企业精益化运营。

B.数据赋能：深挖数据核心价值，赋能科学决策实施。公司整合各园区、各业务板块核心数据资源，搭建标准化数据治理体系，实现数据采集、清洗、分析、应用全流程规范化管控；依托数据建模与智能分析技术，对市场需求研判、生产效能提升、成本精准管控等核心维度进行深度剖析，为经营决策提供科学、精准的数据支撑；建立跨部门数据共享机制，打破数据壁垒、激活数据价值，助力精细化管理落地生根，持续提升核心业务盈利水平。

C.文化赋能：厚植创新型企业文化，凝聚高质量发展合力。公司以"创新、务实、协同、奋进"为核心内核，打造兼具行业特色与企业底蕴的企业文化，着力强化全员效能意识与创新思维；常态化开展效能提升专项培训、创新技能比拼等活动，充分激发员工干事创业的积极性与创新活力；完善员工关怀与激励机制，畅通职业成长通道，增强员工归属感与团队凝聚力，推动全员参与管理提升，凝聚起上下同心、协同奋进的强大发展合力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ✓否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	9,065,592,119.58	7,394,760,416.32	22.59%	6,707,901,850.45
归属于上市公司股东的净资产	5,205,348,136.26	4,502,976,558.73	15.60%	4,468,459,439.70
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,659,907,017.15	3,337,642,949.46	9.66%	2,667,127,862.20
归属于上市公司股东的净利润	720,204,539.60	520,696,454.43	38.32%	222,007,881.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,544,470.60	468,805,021.14	44.53%	164,342,123.52
经营活动产生的现金流量净额	1,156,538,766.70	828,202,089.61	39.64%	534,348,648.61
基本每股收益（元/股）	0.77	0.56	37.50%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.76	0.55	38.18%	0.24
加权平均净资产收益率	12.83%	10.63%	2.20%	4.94%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	823,874,564.84	907,646,249.47	966,546,317.60	961,839,885.24
归属于上市公司股东的净利润	140,992,818.63	170,049,544.56	208,375,325.69	200,786,850.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,879,364.18	158,872,586.86	200,789,787.78	183,002,731.78
经营活动产生的现金流量净额	241,444,906.25	197,455,782.26	331,273,724.56	386,364,353.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ✓否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,941	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
朱双全	境内自然人	14.70%	139,249,514	104,437,135	质押	22,880,000.00	
朱顺全	境内自然人	14.57%	138,031,414	103,523,560	质押	3,800,000.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	3.17%	30,052,865	0	--	--	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.39%	13,176,319	0	--	--	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.17%	11,043,165	0	--	--	
上海理成资产管理有限公司—理成圣远1号入期私募投资基金	其他	1.15%	10,908,026	0	--	--	
招商银行股份有限公司—兴全合睿混合型证券投资基金	其他	1.14%	10,755,627	0	--	--	
兴证全球基金—中国人寿保险股份有限公司—分红险—兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	1.08%	10,185,973	0	--	--	
上海理成资产管理有限公司—理成圣远6号私募证券投资基金	其他	1.01%	9,614,037	0	--	--	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	其他	1.00%	9,498,286	0	--	--	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ✓不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ✓不适用

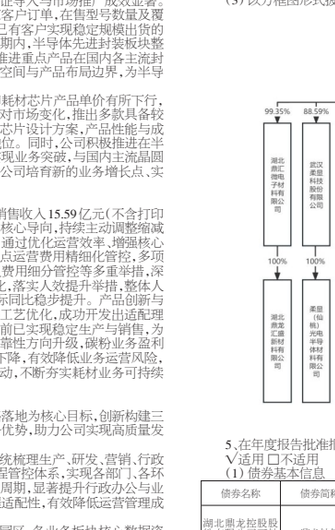
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ✓不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

✓适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
湖北鼎龙控股股份有限公司可转换公司债券	鼎龙转债	123255	2025年04月02日	2031年04月01日	90,977.42	第1年0.20%、第2年0.40%、第3年0.80%、第4年1.50%、第5年1.80%、第6年2.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况			不适用			

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对公司于2025年4月2日发行的可转换公司债券进行了跟踪信用评级，并于2025年7月25日出具了《湖北鼎龙控股股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》。本次公司主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；"鼎龙转债"债券信用等级为"AA"。本次评级结果较前次没有变化。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	39.17%	34.08%	5.09%
扣除非经常性损益后净利润	67,754.45	46,880.5	44.53%
EBITDA全部债务比	52%	71%	-19%
利